

YCD02003L

Re-yingcai® 半导体清洗剂是东莞市盈彩新材料科技有限公司专用于半导体制造过程中去除晶圆及芯片表面污染物（如颗粒物、有机残留、金属离子、助焊剂、光刻胶等）的高纯度专用化学品。产品采用科学的配方设计，能够有效分解并去除晶圆表面的颗粒、金属离子及有机残留物，同时注重与多种基材的兼容性，能较好地保持硅、二氧化硅及金属互连材料的完整性。产品兼顾清洗效能与操作安全，优化溶剂体系，挥发性得到一定控制，刺激性较低。适用于晶圆制造、集成电路封装等领域。



微粒去除

有效清除表面亚微米级颗粒物，减少图形缺陷，提升良率。



金属控制

络合吸附金属杂质离子，降低表面残留，保障电性能稳定。



有机溶解

快速渗透溶解光刻胶及有机聚合物，清洁彻底无残留。



低蚀兼容

对硅片、氧化层及金属布线腐蚀极低，保护精细图形结构。



低残留性

清洗后蒸发残留物极少，避免二次污染，利于后续工艺。



绿色环保

不含卤素及重金属成分，废液处理便捷，符合环保要求。

型号	YCD02003L
比重（20℃）	1.00 – 1.10 g/cm³
表面张力	≤25 mN/m（低表面张力，可渗透亚微米缝隙）
粘度（25℃）	1 – 10 cP
电导率	低电导率，适合精密电子清洗
腐蚀速率	≤0.5 Å/min（对敏感材料腐蚀极低）
清洗时间	5 – 30分钟
操作温度范围	20 – 80℃
漂洗次数	≥3次
闪点	≥60℃（溶剂型）
适用基材	硅晶圆、二氧化硅、铜互连、铝、光刻胶等
应用领域	晶圆制造、集成电路封装